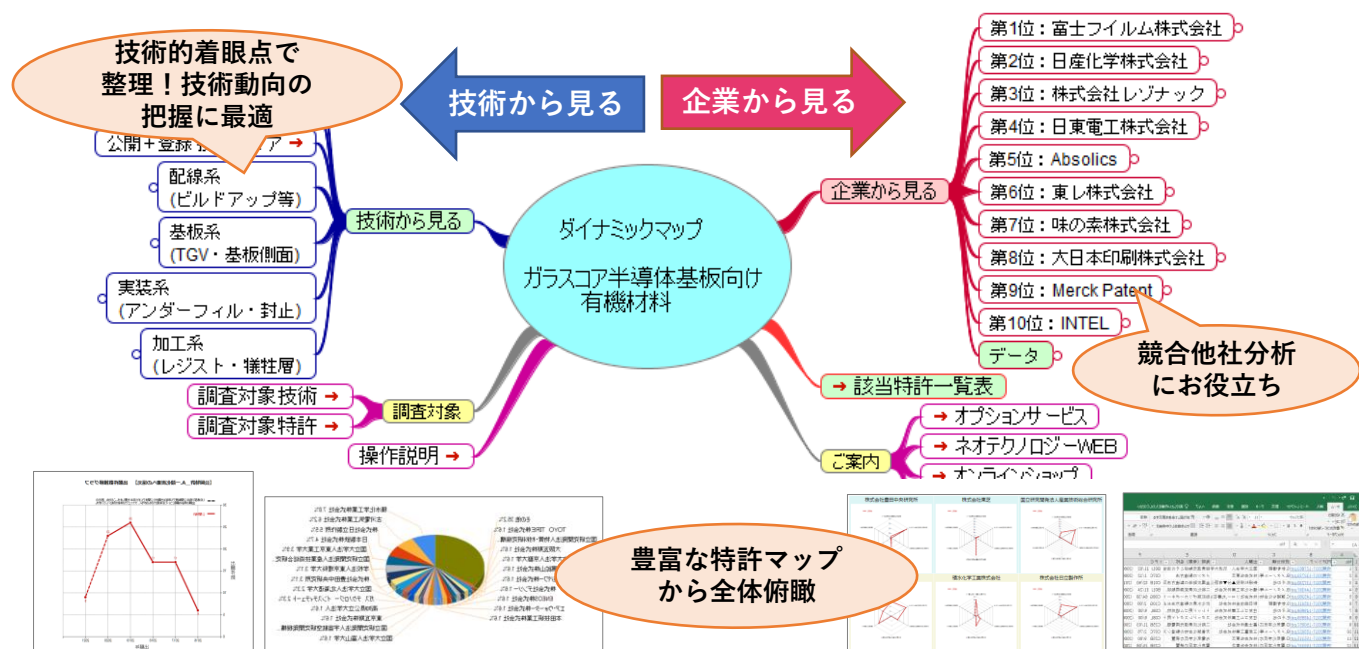


# ガラスコア半導体基板向け有機材料

【体裁】WEB版（ID/PWアクセス） 【価格】180,000円+税 【発刊】2026年9月

AI半導体の高性能化に伴い、半導体パッケージは大型化・高密度化が進んでいます。こうした中、反りや接続不良の解決策として**ガラスコア基板**が注目されています。次世代ガラスコア基板では、新たに樹脂メーカーの市場参入できる可能性があり、各社がビジネスチャンスを狙っています。本ダイナミックマップでは、**配線系、TGV系、実装系、加工系、光電融合系**などの用途に使われる**ガラスコア基板に整合した有機材料**を調査しました。ガラスコア半導体基板のどんな用途で、どんな材料が用いられているかを整理します。ガラスコア基板への新規参入探策に最適です。

- ガラスコア基板に使われる有機材料を全体俯瞰できる
- 競合他社の技術開発動向を把握し、開発テーマを発掘できる
- ガラスコア基板分野への新規参入機会を探せる



## ■ 調査対象とした特許情報

2020年以後出願～2026年7月末までに発行された国内公開・登録特許情報845件を技術と特許に精通した技術スタッフがマニュアル査読し248件を抽出しました。調査結果はネオテクノロジー独自のダイナミックマップ形式でご提供。豊富な特許マップで全体像が俯瞰でき、全文情報リンクで詳細情報を閲覧できます。

## ■ 用途観点から俯瞰

- ・ 配線系(ビルドアップ等)
- ・ 基板系(TGV・基板側面)
- ・ 実装系(アンダーフィル・封止)
- ・ 加工系(レジスト・犠牲層)

## ■ 材料観点から俯瞰

- ・ エポキシ系
- ・ アミド・イミド系
- ・ シリコン系
- ・ アクリル系
- ・ アルカリ可溶性ポリマーなど

詳細・購入はこちら▼

## ■ 主な出願人

富士フイルム、日産化学、レゾナック、日東電工、東レ、味の素、大日本印刷、Absolics、Merck Patent、Intel など

